

実装フェスタ関西2025のご案内

【開催概要】



日時：2025年 7/3 (木) ～ 7/4 (金)

場所：パナソニックリゾート大阪

大阪府吹田市青葉丘南 10-1 TEL 06-6877-0111

分野・競合を超えた技術者間の交流の場を重視。各業界における著名な先生方を講師にお招きし、実装関連技術の将来像を語って頂きます。

HP：<https://jiep.or.jp/event/workshop/jfk2025>

学生参加の優遇

人材育成と若手技術者交流の観点から多くの学生さんの参加を期待。学生参加費を従来以上に優遇（0円～）

スポンサーセッション

スポンサー企業の技術や会社を紹介するセッションを開催。セッション参加学生には、特典【2日目の昼食クーポン】を準備（上限あり）

プログラム

※下記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

基調講演 7/3 (木)

「チップレットがもたらす半導体パラダイムの再構築」

井上史大氏（横浜国立大学）

招待講演 7/3 (木)

「光回路実装技術（OPT）研究会の取り組みについて」

竹崎元人氏（白山）

「光の究極の可能性、レーザーフュージョンによるエネルギー革命と産業の創出」

松尾一輝氏（EX-Fusion）

「高精細ピクセル光源マイクロPLS開発の取り組み」

黒田浩章氏（日亜化学工業）

「量産SiCウエハ 急変するグローバル・サプライチェーンとウエハ品質の動向について」

金子忠昭氏

（QureDA Research, 関西学院大学）

「音楽加振酒について ～音楽の振動によってお酒の何かが変わるのか？」

定家弘一氏（オンキヨー）

「ホリスティック集積工学の体系化に向けて」

福島豊史氏（東北大学）

特別講演 7/3 (木)

「米国の「微細化封じ」をかわす中国の半導体産業」

山田周平氏（桜美林大学）

ナイトセッション 7/3 (木)

招待講演のテーマにて、各講師とグループディスカッション

特別対談 7/4 (金)

「分野間コミュニケーション CROSS POINT 2025 ～技術エコシステム活性化のために学会は何ができるのか～」

パネリスト 木本恒暢氏（応用物理学会 会長，京都大学 大学院工学研究科 教授）

金子忠昭氏（QureDA Research CTO，関西学院大学 工学部教授）

神永 晋氏（JIEP 元会長，東レ株式会社，SKグローバルアドバイザーズ（株））

日暮栄治氏（JIEP 会長，東北大学 大学院工学研究科 教授）

齊藤丈靖氏（JIEP 副会長，大阪公立大学 大学院工学研究科 教授）

岩元勇人氏（JIEP 前理事，ソニーセミコンダクタソリューションズ（株） 研究開発副センター長）

基調講演 7/4 (金)

「IOWN構想実現に向けた光電融合技術」

才田隆志氏

（NTTデバイスイノベーションセンタ）

「YJC教育企画：あなたの知らないガラスサブストレートインターポーター」

八甫谷明彦氏（YJC）

ポスターセッション 7/4 (金)

第1部：7/4 午前発表（奇数番号）
第2部：7/4 午後発表（偶数番号）

発表者	所属	タイトル
カーエレクトロニクス実装		
1 石井厚	武蔵エンジニアリング	超微小 非接触ジェットディスペンサーの紹介
2 三好健太郎	大陽日酸	酸素燃焼を用いて製造した銅ナノ粒子のパワー半導体接合ペーストへの適用検討
3 広岡和洋	奥野製薬工業	セラミック基板上の耐熱性に優れたクラックフリー多孔質銅めっき TOP HEAT ABSORBER CU
サーマルマネジメント & パワーエレクトロニクス実装		
4 小西大介	サーモグラフィティクス	高熱伝導グラファイト複合型高性能ヒートスプレッダーの開発
5 山口翔	東芝	半導体封止材料の吸湿挙動解析手法の開発
6 馬場秀斗	群馬大学	Ag/Ag直接固相接合に及ぼす硫酸塩被膜処理時間の影響
7 平瀬加奈	大阪大学	電解めっきを用いたポーラス銅/はんだ複合構造の作製
8 松田 慎平	Patentix	新しいパワー半導体材料 ルチル構造二酸化ゲルマニウム
9 小野寺浩	シーマ電子	パワー半導体パッケージにおけるはんだ接合ボイド変動がパワーサイクル寿命に及ぼす影響
10 落合武文	ASMP T Japan Limited	Automotive & Power Solution
11 宮田朋希	京セラ	光電集積CPOモジュールの熱設計と評価技術
三次元造形配線・実装応用技術		
12 西尾謙吾	ウシオ電機	エキシマランプを用いた光照射によるCu/SiO2ハイブリッド接合の開発
13 清水英樹	S C R E E Nホールディングス	ハイブリッドボンディング層間膜の状態変化と接合影響
14 三原健太郎	東レエンジニアリング	先端半導体パッケージ用ボンダーの開発
15 長野暢明	J C U	TSV および TGV用硫酸銅電気めっき添加剤の開発
システムインテグレーション実装技術		
16 長谷川一磨	キオクシア	サーマルスロットリングレスSSDに向けた昇圧回路搭載パッケージ開発
17 神谷佑哲	横浜国立大学	超微粒αアルミナスラリーの評価とチップレット集積への応用
18 佐々木滉太	東北大学	自己組織化ハイブリッド接合技術
19 尾形峻太	横浜国立大学	ハイブリッド接合に向けた接合挙動と絶縁膜表面の相関解析
20 佐藤遼一	東北大学	ハイドロゲルを用いたフレキシブルFOWLP技術
電子部品・実装技術		
21 野村康大	東レ	ポリマーハイブリッドボンディング技術のプロセス検討
22 鈴木凌太郎	岩谷産業	ナノNi製造技術
23 鈴木大地	アルバック	2周波ICPを用いたSi Dry Etching技術の開発
24 上山椋平	三菱電機	SiCチップ/基板の固相拡散接合プロセスの短時間化
光回路実装技術		
25 東條彩音	京セラ	表面実装用基板への高密度光配線技術
26 藤重遥	東レエンジニアリング	光電融合デバイス向け薄膜チップ実装技術の開発
27 竹田幸平	積水化学工業	高耐熱光学接着剤
環境調和型実装技術		
28 藤原太一	化研テック	パーティクルの除去メカニズムと 環境適合型パーティクル除去システム
29 川上夏輝	大阪大学	ナノインデンテーション法による低融点合金のクリープ特性評価
配線板とその製造技術		
30 中辻達也	イオックス	ガラス貫通基板（TGV）への密着性と信頼性を有するめっきプライマー
31 泉野巧	奥野製薬工業	ガラス向けスルーホールフィリング硫酸銅めっき「トップルチナGCS」
32 松井康介	東設	脱気水のめっき前処理効果と脱泡メカニズムについて
33 有本太郎	ウシオ電機	VUV表面処理を用いた半導体後工程向け基板実装技術の提案
材料技術		
34 椿幸樹	大阪有機化学工業	ラジカル重合性基が与える耐熱性、誘電特性への影響について
35 友利大介	大阪ソーダ	銅基板上に接合可能な銀ナノ粒子を用いた焼結銀接合材の評価
36 深田和宏	芝浦機械	無機材料膜と有機材料基板の密着性改善による耐環境性の向上
37 武田光市	日本スベリア社	銅と銀を含有した焼結型接合材
38 山崎浩次	群馬大学	金属塩生成接合法を応用したフラックスレスはんだ付の検討
39 江山誉昭	花王	サブミクロン銅粒子を含む銅接合材が形成する銅接合層の熱安定性と機械特性
40 山口大輔	大和化成	制御可能なポーラス構造が得られる粗化Agめっきの提案
41 齋藤正裕	東レリサーチセンター	ハイブリッド接合プロセスの最適化：絶縁膜材料、表面活性化処理の評価
高速伝送実装		
42 山口貴史	荒川化学工業	半導体後工程に適應する低誘電ポリイミド樹脂の物性と使用例
43 今野英明	積水ポリマテック	高周波低電損異方導電ラバーシート
44 伊原めぐみ	D I C	高速伝送用低誘電ボンディングシートの開発
信頼性解析技術		
45 熊田拓朗	三菱マテリアル	AuSn合金はんだ接合層の金属間化合物が及ぼす信頼性への影響
46 長居秀幸	T D K	はんだ付け性試験の濡れ性挙動に基づく新規前処理の検討
検査技術		
47 田中志穂	Excillum AB	先端パッケージング計測のための高解像度ナノフォーカスX線源
48 山本拓志	イオンテクノセンター	アドバンスドパッケージの故障解析技術
49 阿久津成一	産業分析センター	電子材料・半導体分野の分析提案（表面解析およびPFAS/RoHS分析）
50 八子基樹	パナソニック E & C	高度外観検査を可能にする高感度ハイバースペクトルカメラの開発

